

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展可能的资金需求，2024年度公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币3亿元（含本数）的授信额度及办理相应的贷款等业务。

授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与金融机构具体协商办理。以上授信额度不等于公司未来实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的需求及银行最终批准确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度经公司董事会审议通过后生效，有效期为一年。同时董事会授权董事长胡云平先生代表公司审核并签署在上述授信额度内的所有相关文件并办理相关手续。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2024年4月24日